

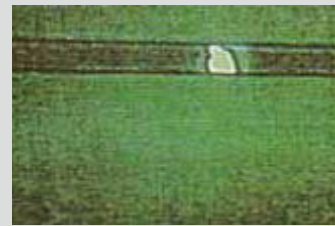
【特徴】PSR 像杂物形状那样剥落的缺陷。

【Characteristics】Photo solder resist is not coated in the form of a foreign object that existed.

【原因・判断ポイント・発生工程】P S R パターン焼付露光時に A W F の上に存在したゴミにより、露光阻害されたことにより出来たもの（P S R 焼付露光～P S R 現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 PSR 图形曝光时，由于 AWF 上存在的灰尘妨碍曝光而引起的（PSR 曝光～PSR 显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Exposure light is blocked by a dust on a phototool at the time of photo solder resist application, causing the defect. (Photo solder resist exposure - development process)



【コメント】顕微鏡倍率×100

【注釋】显微镜倍率×100

【Comments】Magnification: ×100



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

#### 2-2-2-4 SR ピンホール／SR 的针孔／Solder resist pinhole

【特徴】S R が比較的小さい穴状(真円とは限らない)に付着していない状態の欠陥

【特徴】SR 有比较小的孔状(不限于圆形)剥落的缺陷。

【Characteristics】Solder resist does not coat in the form of a small hole (not necessarily a perfect disk)

【原因・判断ポイント・発生工程】S R 印刷版の部分的目詰まりにより、S R インクが印刷されなかったり、P S R パターン焼付け時の小さな異物の介在により、未露光部が現像除去されて出来たもの（S R と塗布、P S R パターン焼付露光、P S R 現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于 SR 网版的局部堵塞，不能挤出油墨，或者由于 PSR 图形曝光时夹杂小杂物，显影时不能清除未曝光部而引起的（涂布 SR、图 PSR 形曝光、PSR 显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Solder resist ink is not printed on a board due to a partial clogging of the printing screen. Or photo solder resist is missing at the area to be coated due to the presence of a small foreign object which blocks the exposure light. The solder resist of unexposed area is removed by developing.



【コメント】顕微鏡倍率×20

【注釋】显微镜倍率×20

【Comments】Magnification: ×20



【コメント】顕微鏡倍率×20

【注釋】显微镜倍率×20

【Comments】Magnification: ×20